

課題番号 : F-12-WS-0052
支援課題名 (日本語) : ミリング装置を用いた素子作製検討
Program Title (in English) : Device fabrication using ion-milling
利用者名 (日本語) : 三田正弘
Username (in English) : Masahiro Mita
所属名 (日本語) : 株式会社 協同インターナショナル
Affiliation (in English) : Kyodo International Inc.

概要 (Summary) :

イオンミリング法は、スパッタ装置 SPC350 等を用いて金属膜を被着させた場合に、材料を選ばずに微細なパターンニングが可能な優れたエッチング法である。しかし、実際の加工にあたっては、マスクとの選択比等を考慮しなければならない。今回、エッチング速度を左右する因子および高選択化、さらには、ミリング法特有の課題を明確にし、デバイス適用への基礎検討を行った。

関連特許 (Patent) :

なし。

実験 (Experimental) :

なし。

結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

その他・特記事項 (Others) :

なし。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし。